

证券代码：002436

证券简称：兴森科技

公告编号：2021-03-016

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年非公开发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”）已经公司于 2021 年 3 月 5 日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关文件的要求，公司对本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并提出了填补回报的具体措施，相关主体对公司填补回报拟采取的措施得到切实履行做出了承诺，具体内容说明如下：

一、本次发行摊薄即期回报对公司的影响

本次募集资金使用计划已经过管理层的详细论证，符合公司的发展规划，经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，有利于提高公司的运营效率、提升公司综合竞争能力，从而增强公司盈利能力。

本次募集资金完成后，公司净资产和总股本规模将有较大增长，但是募集资

金投资项目建成投产并产生效益需要一定时间，公司存在由于股本规模增加，而相应收益短期内无法同步增长，导致即期回报被摊薄的风险。

（一）主要假设

1、假设宏观经济环境和市场情况没有发生重大不利变化；

2、假设本次非公开发行预计于 2021 年 11 月底完成发行，该完成时间仅为公司估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；

3、假设本次非公开发行股票数量为 297,581,500 股，该发行股票数量仅为公司用于本测算的估计，最终以经中国证监会核准后实际发行股票数量为准；

4、在预测公司总股本时，以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,487,907,504 股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化，包括限制性股票、可转换公司债券的影响；

5、根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字 2020 第 2430 号审计报告，公司 2019 年归属于母公司股东的净利润为 29,191.67 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 25,691.06 万元；

假设公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别在 2019 年的基础上按照持平、增长 15%和下降 15%的业绩变动幅度测算；

6、假设暂不考虑除本次非公开发行募集资金和净利润之外的其他经营或非经营因素对公司资产状况、盈利能力和净资产的影响；

7、上述假设仅为测算本次以公司 2019 年的经营成果为基础，未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的其他影响。该假设分析不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体测算情况如下：

项目	2019 年 12 月 31 日 /2019 年度	发行前 (2021 年/2021 年 12 月 31 日) (预测)	发行后 (2021 年/2021 年 12 月 31 日) (预测)
总股本 (万股)	148,790.75	148,790.75	178,548.90
情形 1、假设 2021 年公司净利润较 2019 年上升 15%			
归属于母公司所有者的 净利润 (万元)	29,191.67	33,570.42	33,570.42
扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净 利润 (万元)	25,691.06	29,544.72	29,544.72
基本每股收益 (元/股)	0.1962	0.2256	0.1880
稀释每股收益 (元/股)	0.1962	0.2256	0.1880
扣除非经常性损益后基 本每股收益 (元/股)	0.1727	0.1986	0.1655
扣除非经常性损益后稀 释每股收益 (元/股)	0.1727	0.1986	0.1655
情形 2、假设 2021 年公司净利润较 2019 年持平			
归属于母公司所有者的 净利润 (万元)	29,191.67	29,191.67	29,191.67
扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净 利润 (万元)	25,691.06	25,691.06	25,691.06
基本每股收益 (元/股)	0.1962	0.1962	0.1635
稀释每股收益 (元/股)	0.1962	0.1962	0.1635
扣除非经常性损益后基 本每股收益 (元/股)	0.1727	0.1727	0.1439
扣除非经常性损益后稀 释每股收益 (元/股)	0.1727	0.1727	0.1439
情形 3、假设 2021 年公司净利润较 2019 年下降 15%			
归属于母公司所有者的 净利润 (万元)	29,191.67	24,812.92	24,812.92
扣除非经常性损益后归 属于母公司所有者的净 利润 (万元)	25,691.06	21,837.40	21,837.40
基本每股收益 (元/股)	0.1962	0.1668	0.1390
稀释每股收益 (元/股)	0.1962	0.1668	0.1390
扣除非经常性损益后基 本每股收益 (元/股)	0.1727	0.1468	0.1223
扣除非经常性损益后稀 释每股收益 (元/股)	0.1727	0.1468	0.1223

注 1：基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 条——净资产收益和每股收益率的计算及披露》计算方式计算。

注 2：由于上表的计算假设本次非公开发行于 2021 年 11 月底完成发行，因此预测的发行后

的每股收益较发行前的每股收益变动较小。

注 3：上述每股收益未考虑可转换公司债券转股的影响。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行将扩大公司股本及净资产规模，在盈利水平一定的条件下，将会摊薄公司的每股收益和净资产收益率。本次融资后，公司业务规模的扩大和业绩的体现需要一定的时间，同时由于募集资金的投入需要经历一定的建设周期才能获得收益，短期内相关利润难以全部释放，从而导致公司的每股收益和净资产收益率短期内存在被摊薄的风险。

公司提醒投资者，本次发行尚需监管部门核准，能否取得核准、取得核准的时间及发行完成时间等均存在不确定性。一旦前述分析的假设条件或公司经营发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

基于上述与本次发行相关的特定风险，公司敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

三、本次发行融资的必要性和合理性

（一）募集资金投资项目概况

本次发行募集资金总额不超过 20 亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目	实施主体	项目总投资额	拟投入募集资金
1	宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目——年产96万平方米印刷线路板项目（以下简称“宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目”）	宜兴硅谷电子科技有限公司	157,966.52	145,000.00
2	广州兴森快捷电路科技有限公司国产高端集成电路封装基板自动化生产技术改造项目（以下简称“广州兴森集成电路封装基板项目”）	广州兴森快捷电路科技有限公司	36,227.44	15,000.00
3	补充流动资金及偿还银行贷款	兴森科技	40,000.00	40,000.00
合计			234,193.96	200,000.00

本次发行募集资金总额约 200,000 万元，扣除发行费用后，计划 145,000 万元用于宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目，15,000 万元用于广州兴森集成电路封装基板项目，40,000 万元用于补充流动资金及偿还银行贷款。

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述募集资金拟投入总额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募投项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。

（二）本次发行的必要性和可行性

1、宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目

（1）项目建设必要性

①提升高端产品的小批量及量产供应能力，满足客户一站式需求

公司是国内知名的印制电路板样板、快件、小批量板的设计及制造服务商，为华为、中兴通讯、烽火通信、京信通信、中际旭创、光迅科技等近 5000 家企业提供研发、测试及小批量供应阶段的专业化服务。随着 5G、光模块等市场需求的快速增长，公司高端产品小批量及量产的产能瓶颈凸显，不能满足客户的一站式需求，制约了公司业务的进一步发展。

②顺应 5G 市场需求及技术需求

2019 年 6 月 6 日工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。国家工信部跨过试用牌照直接向通信运营商发放商用牌照，从政策层面加速 5G 商用进程。随着 5G 商用牌照发放，标志着中国加速进入到 5G 时代。

2019 年是中国 5G 商用元年。全国各省将 5G 列为 2019 年重点发展任务，并相继出台 5G 发展规划。自 2019 年 6 月 6 日工业和信息化部正式颁发 5G 商用牌照以来，各大运营商正紧锣密鼓的布局 5G，随后陆续推出 5G 手机套餐，开始正

式商用。5G 技术将融合云计算、大数据、人工智能、物联网等新一代信息技术，实现万物互联并全面赋能数字经济发展。

Prismark 数据显示，2009 年到 2016 年全球 PCB 在通信领域占比显著提升，由 22%增加至 29%，2019 年达到 33%，并逐渐取代计算机成为 PCB 应用最大的领域，伴随着通信技术的快速发展以及未来 5G 的商用，PCB 在通信领域的应用将进一步深化。5G 时代将影响整个通信行业以及消费电子行业的未来发展轨迹。随着 5G 的推进，频段增加需要更多射频元件，射频前端器件的数量增加使得 PCB 需求提升；同时高速大容量成为 PCB 行业的发展趋势，对频率、层数等提出更严格的要求，核心设备高速 PCB 层数达到 40 层以上，行业技术将进一步分化和细化。

公司通过本次募投项目的实施，可以有效提高公司产能和产品质量，能更好的适应 5G 时代对产品的要求，提高公司产品的竞争力。

③Mini LED 未来需求空间广阔

2019 年以来 Mini LED 产品密集发布，苹果、TCL、海信、华硕、群创、友达、京东方等厂商纷纷推出 Mini LED 背光或类似技术的电视、显示器、VR 和车载显示等终端产品，Mini LED 开始迎来大规模应用，对专用 PCB 的需求也将迎来爆发式增长。

Mini LED 当前主要在两种显示中应用：LCD 背光显示和商业显示。Mini LED 背光模组可助力 LCD 升级，实现超薄、多区局部调光背光单元，使外形尺寸和对比度性能接近或优于 OLED，让 LCD 在中高端市场能与 OLED 同台竞争，LCD 分区调光背光技术已经成熟，成本也在不断下降，未来有望迎来规模放量。Mini LED 商业显示是小间距 LED 商业显示的升级，随着 2020 年《Mini LED 商用显示屏通用技术规范》，Mini LED 商业显示有望迎来有序快速发展，并逐步在大尺寸电视、影院等场景落地。

公司通过本次募投项目的实施，可以帮助公司布局 Mini LED 市场，把握 Mini LED 的市场机会。

④把握服务器市场发展机遇

目前，我国高性能计算机需求增长显著。受益于各地政府相继推进大数据和智慧城市建设，对大型数据中心的需求越来越强烈，由此带动服务器产品市场的繁荣；在国家“信息安全”发展战略下，政府、能源、电力、金融等关键领域对服务器的国产化替代趋势明显，为国产服务器市场带来了良好的发展机遇。

PCB 在服务器中的应用主要包括主板、电源背板、硬盘背板、网卡、Riser 卡等，其特点主要体现在高层数、高纵横比、高密度及高传输速率。随着服务器核心芯片计算能力的提高，对于 PCB 的层数及材料的要求也越来越高，PCB 层数的增加对供应商的整体加工能力提出更高要求，高端服务器的发展成为高端 PCB 生产技术升级的推动力。

公司通过本次募投项目的实施，可以帮助公司把握服务器市场发展机遇。

⑤提高光模块产品竞争力

光模块是信息光电子技术领域核心的光电子器件，是构建现代高速信息网络的基础。2012 年工信部颁布《电子信息制造业“十二五”发展规划》，明确指出将推动智能光网络和大容量、高速率、长距离光传输、光纤接入（Fttx）等技术和产品的发展，近年来，国家制定了多项产业政策和实施方案以支持行业发展，助力行业升级。2018 年工信部发布的《中国光电子器件产业技术发展路线图（2018-2022 年）》中对光模块器件发展提出了新的标准。

光模块下游主要应用于电信承载网、接入网、数据中心及以太网三大场景。根据 Light Counting 预测，2018 年全球光模块市场规模约 60 亿美元，其中电信承载网市场规模 17 亿美元，每年以 15% 的速度增长，接入网市场规模约 12 亿美元，年增长率约 11%，而数据中心和以太网市场规模已达 30 亿美元，未来 5 年复合增长率达 19%。

公司通过本次募投项目的实施，可以提高公司光模块产品的竞争力，缩小与国外强势企业光模块技术差距，布局空间广阔的光模块市场。

（2）项目建设可行性

①综合研发技术能力强

公司兴森研究院拥有规模过百人的研发专业团队，导入国际先进的 IPD 研发

管理体系，是新产品及技术的孵化器。公司被认定为“国家高新技术企业”、“国家知识产权示范企业”、“广东省创新型企业”，先后组建了 3 个省级研发机构“广东省省级企业技术中心”、“广东省封装基板工程技术研究中心”、“广东省高密度集成电路封装及测试基板企业重点实验室”，承担了 1 项国家科技重大专项 02 专项项目和多项省市级科技项目，具备承担国家级政府项目的能力。

②样板业务为本项目提供了丰富的客户资源

公司是我国经营规模最大的 PCB 样板生产企业，为华为、中兴、烽火、中际旭创、浪潮信息、星网锐捷等近 4000 家高科技企业提供产品研发阶段的 PCB 样板生产制造服务。客户产品研发试制定型后，一般会将 PCB 批量订单委托给批量生产厂家。本项目的实施旨在提升公司的批量板生产制造能力，为客户提供一站式全产业链条服务。样板业务丰富的客户资源为项目的产能消化提供的一定的客户保障。

③市场前景广阔

根据 Prismark 预测数据，受贸易摩擦等因素影响，2019 年全球 PCB 行业产值约为 613.4 亿美元、同比小幅下滑 1.7%，预期 2020 年全球 PCB 行业产值增长 2%，2019-2024 年复合增长率约为 4.3%，未来 PCB 行业向中国大陆转移的趋势仍将持续、行业集中度仍将进一步提升。从区域市场看，中国市场表现优于其他区域，2019 年中国 PCB 行业产值约 329.42 亿美元、小幅增长 0.7%，全球市场占比约 53.7%，2019-2024 年中国 PCB 行业产值复合增长率约为 4.9%，仍将优于全球其他区域。随着 5G、大数据、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展，以及产业配套、成本等优势，中国 PCB 行业的市场占比仍将进一步提升。

同时 5G 通信、Mini LED、服务器和光模块等新兴领域的快速崛起，提升了未来 PCB 行业的增长潜力，并推动行业向高端化发展，也为行业参与者提供了难得的发展机遇，为项目实施提供了市场环境支撑。

④国家产业政策扶持

电子元件行业作为我国的重要行业之一，国家先后出台了多项政策以鼓励 and 促进电子信息行业的发展。

2016 年 12 月发布的《“十三五”国家战略新兴产业发展规划》提出，“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”，推动“印刷电子”等领域关键技术研发和产业化。2019 年 1 月，工信部发布《印制电路板行业规范条件》《印制电路板行业规范公告管理暂行办法》，以加强印制电路板行业管理，提高行业发展水平，引导产业转型升级和结构调整，推动印制电路板产业持续健康发展。

2020 年 3 月，中共中央政治局常委会提出，加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。2020 年 5 月 22 日，《2020 年国务院政府工作报告》提出，重点支持“两新一重”（新型基础建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）建设。

新型基础设施建设（下称“新基建”），主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链，其中 PCB 作为电子产品之母，对新基建主要领域的支撑作用不言而喻，未来随着国家对新基建的投入逐渐增大，市场对适用于工业控制方向的 PCB 产品需求将会出现较大幅度增长。

2、广州兴森集成电路封装基板项目

（1）项目建设必要性

①公司集成电路封装基板业务发展迅速，产能已遇到瓶颈，不能满足客户交货需求

公司从 2012 年开始进入集成电路封装基板业务，经过多年的发展，已在客户、技术、工艺能力、人员和管理团队等方面积累了较多经验，并取得了快速的发展。公司目前已经积累了多家优质客户，并通过三星等国际知名客户的认证。

封装基板行业的客户主要为国际知名芯片企业，大批量订单较多，其对封装基板供应商的生产和交付能力具有较高的要求，因此，充足的产能是获取全球知名客户订单的重要保证，公司现有产能已不能满足业务发展的需要，因此，公司亟需扩大封装基板业务产能，提升供货能力，为公司封装基板业务的后续发展提供保障。

②世界范围内集成电路封装基板产能不足问题凸显

受 5G 建设、可穿戴设备、服务器市场等需求影响，全球半导体市场迎来了新的增长周期。根据半导体工业协会数据，2020 年全球半导体工业销售额较 2019 年增长 6.5%，同时，根据世界半导体贸易统计（WSTS）预计，2021 年全球半导体市场销售额将达到 469.40 亿美元，较 2020 年增长 8.4%。半导体新的增长周期将带动上游封装基板市场需求，根据 Prismark 预测，到 2024 年全球封装基板市场规模将达到 111.46 亿美元，2019 年到 2024 年复合增长率达到 6.5%。

在高速需求增长的背景下，全球封装基板现有产能不足问题凸显，2020 年下半年，受封测市场需求影响，上游封装基板行业整体紧缺，封装基板供需不平衡推动价格上涨，下游日月光等封测企业纷纷上调了封测价格。公司募投项目的实施有助于抓住市场机遇，增强封装基板业务盈利能力。

③提高芯片产业链自主可控能力，解决“卡脖子”问题

集成电路封装基板是集成电路产业链封装环节的关键载体，是芯片生产过程中重要的、不可或缺的材料。集成电路封装基板行业具有技术壁垒、资金壁垒和市场壁垒较高的特点，市场长期被日本、韩国、台湾等外资企业占据着，前十大集成电路封装基板企业市场规模占比超过了 80%；由于中国集成电路封装基板发展起步较晚，目前只有深南电路、珠海越亚和本公司等少数几家本土企业具备相应生产能力。

随着近年来中国半导体投入加大，中国封测市场规模不断增长，根据中国半导体行业协会数据，中国封测销售额从 2014 年的 1,255.9 亿元增长至 2019 年的 2,349.7 亿元，目前中国封测产业占世界封测规模已经达到 60%以上，封测是中国半导体产业重要的支柱。而作为封测最主要的材料，封装基板市场却长期被外资占据着。2018 年以来的中美贸易摩擦事件，美国对中国部分高科技企业采取了不同程度的技术封锁，显露了我国在部分高新技术领域的短板，凸显了关键技术自主可控的重要性，敲响了产业链安全的警钟，提高自主可控水平，避免关键领域受到“卡脖子”制约至关重要。

公司募投项目的实施有助于提高中国芯片关键领域自主可控能力，增加芯片产业供应链安全性。

（2）项目建设可行性

①国家及行业政策支持项目实施

集成电路封装所属的集成电路产业既是高附加值产业，也是电子产业的基础，更是未来经济高速发展的增长点。近年来，集成电路产业已上升至国家战略层面，有关部门相继颁布了一系列的鼓励政策，如 2014 年 6 月，国务院印发《国家集成电路产业发展推进纲要》，明确了集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，并提出要提升先进封装测试业发展水平，突破集成电路关键装备和材料；2015 年 5 月，国务院颁布的《中国制造 2025》指出集成电路属于大力推动的重点领域，并明确需提升封装产业和测试的自主发展能力；《2018 年国务院政府工作报告》指出，要加快制造强国建设，推动集成电路等产业发展，推进与国际先进水平对标达标。本募集资金投资项目既符合公司的战略部署，亦响应国家对集成电路行业的产业规划。

②公司集成电路封装基板技术已经成熟

公司从 2012 年开始进入集成电路封装基板业务，经过多年的研发投入和技术积累，公司的技术已经成熟，并通过三星等国际知名客户的认证，产品良率可保持在 95%以上。

③已经积累了丰富的客户资源

经过多年的积累，公司批量供货的集成电路封装基板客户主要有三星、长江存储、华天、长电科技、WDC、UniMOS 等，已经通过了众多客户的认证，为了扩产提供了客户资源保障。

④市场需求旺盛

集成电路封装基板是集成电路产业链封装环节的关键载体，是芯片生产过程中重要的、不可或缺的材料，是封装过程中价值量最大的材料。受 5G 建设、可穿戴设备、服务器市场等因素影响，集成电路产业将迎来新的增长周期，新一轮产业增长将带动上游封装基板市场需求，根据 Prismark 预测，到 2024 年全球封装基板市场规模将达到 111.46 亿美元，2019 年到 2024 年复合增长率达到 6.5%。中国作为全球最大的封测产业地，对封装基板具有较大的需求，因此，本项目的市场前景广阔。

3、补充流动资金及偿还银行贷款

(1) 业务规模不断扩大，运营资金需求量增加

近年来，公司业务稳定发展，2017 年-2019 年营业收入分别为 328,296.48 万元、347,325.86 万元和 380,372.22 万元，持续增长，对运营资金的需求也将随之扩大，运营资金缺口需要填补。公司通过此次非公开发行股票资金补充部分流动资金及偿还银行贷款，可以缓解公司发展面临的流动资金压力，为业务发展未来经营提供资金支持，从而提升公司市场占有率和行业竞争力，为公司健康、稳定、持续的发展夯实基础。

(2) 改善公司资本结构，增强短期偿债能力

截至 2020 年 9 月 30 日，公司的短期借款及长期借款分别为 83,117.52 万元及 47,694.88 万元，资产负债率为 43.82%，借款金额及资产负债率处于相对较高水平，公司存在一定的偿债压力，通过非公开发行股票募集资金补充流动资金及偿还银行贷款将可降低公司负债规模，通过权益类融资部分替代债务类融资，可以进一步优化债务结构，满足中长期资金需求，同时可有效增加公司运营资金总规模，增强公司偿债能力，从而降低公司的流动性风险。

四、公司应对本次发行即期回报摊薄采取的措施

为了维护广大投资者的利益，保证公司本次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，增强公司对股东的持续回报能力，公司拟采取多种措施填补即期回报。具体如下：

(一) 强化募集资金管理

公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理办法》，以规范募集资金使用。根据《募集资金管理办法》和公司董事会的决议，本次募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。公司建立了募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用，以保证募集资金规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（二）进一步提升公司治理水平

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，进一步提高经营和管理水平，确保股东能够充分行使权利。公司也将加强企业内部控制，发挥企业管控效能，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本管理，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

（三）积极稳妥地推动募集资金的使用，提高盈利能力

本次非公开发行募集资金投资项目包括：宜兴硅谷印刷线路板二期工程项目、广州兴森集成电路封装基板项目和补充流动资金及偿还银行贷款项目，董事会已对本次非公开发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募投项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。

本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高资金使用效率，争取募投项目早日竣工并实现预期效益，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报摊薄的风险。

（四）在符合利润分配条件的情况下，公司将积极回报股东

公司已经按照相关法律法规和《公司章程》制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将按照法律法规的规定和《公司章程》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的约定，严格执行股东大会审议通过的股东分红回报计划，积极推动对股东的利润分配，保持利润分配政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

五、公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人对本次发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为充分保护本次发行摊薄即期回报的填补措施得到切实执行，公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺如下：

（一）公司董事、高级管理人员的承诺

公司董事、高级管理人员作出如下承诺：

1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

4、承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、若公司未来推出股权激励政策，承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

7、本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

（二）控股股东、实际控制人的承诺

公司控股股东和实际控制人邱醒亚作出如下承诺：

1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、自承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；

3、本人作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人接受按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发

布的有关规定、规则，对本人作出的相关处罚或采取相关监管措施。本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项审议程序

关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的事项已经公司2021年3月5日召开的第五届董事第二十五次会议审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，并将提请公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2021年3月8日